

中国智能座舱SoC芯片行业发展趋势分析与未来 前景预测报告（2025-2032年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国智能座舱SoC芯片行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2025-2032年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202508/760478.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联系人：客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

一、乘用车前装智能座舱搭载率持续攀升下，智能座舱SoC芯片需求水涨船高
受EE架构升级带动，座舱的整体控制由过去机械化、分布式向电子式、集成式发展，并由驾驶舱概念逐渐向全车舱内空间延伸，同时加大安全要求，座舱集成复杂度持续增加，需要处理的数据量和复杂度均趋增加。传统的MCU芯片已无法应对这种挑战，因此选用算力更为强大的SoC芯片成为行业的必然趋势。

随着我国乘用车前装智能座舱搭载率持续攀升，智能座舱SoC芯片需求水涨船高。2024年上半年我国乘用车前装智能座舱搭载率突破70%，到年底已达到73.4%，预计2025年将跨越80%大关。2022-2023年我国智能座舱SoC芯片市场规模由88亿元增长至108亿元，预计2024年、2025年、2026年我国智能座舱SoC芯片市场规模将达143亿元、202亿元、266亿元，同比增长32.4%、41.3%、31.7%。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

二、10-25万元价格区间车型座舱域控标配率快速增长，智能座舱SoC芯片向中端车市场渗透

当前，25-30万元价格区间、50万元价格区间车型仍为座舱域控标配主力军，搭载率均达到了70%。但10-25万元价格区间车型座舱域控标配率呈快速增长的态势，由2022年的9.01%提升至28.42%，同比增长了2.58倍；10-25万元价位区间新车交付约占整体市场的58%，而座舱域控制器渗透率仅有28.42%，伴随AI赋能，智能座舱SoC芯片中低端车市场渗透将进一步提升。

数据来源：观研天下数据中心整理

15-25万标配智能座舱自主品牌新能源车交付量及其SOC芯片 排名 车型 座舱域控芯片交付量(辆)

1	理想L6	高通8295	121,892
2	深蓝S07	高通8155	75,289
3	银河L7	高通8155	73,923
4	银河E5	芯擎(龍鷹一号)	73,522
5	小米SU7	高通8295	69,422
6	领克08	芯擎(龍鷹一号)	67,394
7	零跑C10	高通8295/8155(混合配置)	66,989
8	哈弗猛龙	高通8155	63,037
9	零跑C11	高通8295/8155(混合配置)	58,333
10	银河L6	高通8155	56,562

资料来源：观研天下整理

三、智能座舱市场高阶化演进，高性能智能座舱SoC芯片将成行业重要发展趋势
随着智能座舱市场进一步向多元化、高阶化演进，舱泊一体、舱驾一体、AI座舱逐步成为主机厂新的需求点，智能座舱SoC芯片市场进入新的发展阶段。

智能座舱集成化进一步提升：在智能座舱SoC中集成5G调制解调器、Wi-Fi 7、BT、V2X等模块，通过单芯片实现高速连接与智能计算能力的融合，提升车载系统的实时性、多任务处理能力和用户体验渐成趋势，同时有助于主机厂降本，省去外置T-Box。

系统级封装（SIP）快速渗透：面对电源需求增加、器件品类日益繁杂的趋势，传统COB设计面临PCB可靠性、厚度和翘曲控制等难题；而SIP封装，通过BGA植球工艺、背面电容设计以及丰富的Underfill工艺经验，可以很好地解决了客户在硬件设计、工艺和可靠性上面临的挑战，确保产品在严苛环境下稳定运行。

制程从7nm向4nm及以下迈进：主流芯片制程从7nm向4nm及以下迈进，2024年7nm及以下制程芯片占比达到36%，2030年预计突破65%。下一代将向4nm、3nm演进，相对目前使用较多的7nm、5nm制程芯片，4nm在晶体管密度、性能、功耗控制上都有明显的提升，可更好地支持AI座舱在不同应用场景下的高吞吐量、持续运行的AI计算任务。

部分集成5G Modem的高性能座舱SOC产品	产品型号	量产时间	制程	通信模块集成详情
高通8397(SnapdragonCockpit Elite)		2025年	4nm	集成5G Modem，X65调制解调器支持Sub-6GHz和毫米波适配V2X通信
比亚迪D9000(联发科天玑9200)		2024年	4nm	集成5G Modem(联发科M80基带)支持Sub-6GHz频段，下行速率7Gbps兼容2G-4G网络Wi-Fi 7理论峰值速率6.5Gbps支持蓝牙5.3
联发科CT-X1		2025年	3nm	集成5G Modem支持Sub-6GHz和毫米波频段Wi-Fi 7理论峰值速率46Gbps支持双频蓝牙5.3支持NTN卫星通信
联发科MT8676		2024年	4nm	集成5G Modem支持Sub-6GHz支持频段:n1/n3/n5/n8/n28a/n41/n78
联发科MT2715		2023年	7nm	集成5G Modem支持Sub-6GHz

资料来源：观研天下整理

四、国产供应商快速崛起、外资巨头地位松动，智能座舱SOC芯片市场格局生变

受技术变革、产品更新换代推动，智能座舱SOC芯片市场格局开始发生变化。外资巨头凭借深厚的技术积累和先发优势占据智能座舱SOC芯片市场主导地位。根据数据，2023年，高通、AMD、瑞萨、英特尔、三星、德州仪器合计占据95%的市场份额。

数据来源：观研天下数据中心整理

近年来，国产供应商紧抓新技术机遇，迅速崛起，如芯驰科技新一代AI座舱SoC-X10，采用4nm工艺制程，NPU算力达到40TOPS，同时还匹配了128位LPDDR5X内存接口，带宽高达154 GB/s，是当前量产的旗舰座舱芯片带宽的两倍以上，可以实现7B（70亿参数）模型每秒输出20 token/s，响应时间控制在1秒以内。国产供应商竞争力显著增强，市占率由2023年的不足3%提升至2024年的10%以上。其中，芯驰科技2024年市占率达4.8%，赶超英特尔、三星和德州仪器三大巨头，位列第四位，相较2023年上升三个席位，这进一步验证了国产芯片在市场中的快速进步。

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）

注：上述信息仅供参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。
个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。

更多图表和内容详见报告正文。

观研报告网发布的《中国智能座舱SoC芯片行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2025-2032年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。

本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。

本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

目录大纲：

【第一部分 行业定义与监管】

第一章 2020-2024年中国 智能座舱SoC芯片 行业发展概述

第一节 智能座舱SoC芯片 行业发展情况概述

- 一、 智能座舱SoC芯片 行业相关定义
- 二、 智能座舱SoC芯片 特点分析
- 三、 智能座舱SoC芯片 行业基本情况介绍
- 四、 智能座舱SoC芯片 行业经营模式

（1）生产模式

（2）采购模式

（3）销售/服务模式

五、 智能座舱SoC芯片 行业需求主体分析

第二节 中国 智能座舱SoC芯片 行业生命周期分析

- 一、 智能座舱SoC芯片 行业生命周期理论概述
- 二、 智能座舱SoC芯片 行业所属的生命周期分析

第三节 智能座舱SoC芯片 行业经济指标分析

- 一、 智能座舱SoC芯片 行业的赢利性分析
- 二、 智能座舱SoC芯片 行业的经济周期分析

三、	智能座舱SoC芯片	行业附加值的提升空间分析	
第二章 中国	智能座舱SoC芯片	行业监管分析	
第一节 中国	智能座舱SoC芯片	行业监管制度分析	
一、	行业主要监管体制		
二、	行业准入制度		
第二节 中国	智能座舱SoC芯片	行业政策法规	
一、	行业主要政策法规		
二、	主要行业标准分析		
第三节 国内监管与政策对	智能座舱SoC芯片	行业的影响分析	
【第二部分 行业环境与全球市场】			
第三章 2020-2024年中国	智能座舱SoC芯片	行业发展环境分析	
第一节 中国宏观环境与对	智能座舱SoC芯片	行业的影响分析	
一、	中国宏观经济环境		
二、	中国宏观经济环境对	智能座舱SoC芯片	行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对	智能座舱SoC芯片	行业的影响分析	
第三节 中国对外贸易环境与对	智能座舱SoC芯片	行业的影响分析	
第四节 中国	智能座舱SoC芯片	行业投资环境分析	
第五节 中国	智能座舱SoC芯片	行业技术环境分析	
第六节 中国	智能座舱SoC芯片	行业进入壁垒分析	
一、	智能座舱SoC芯片	行业资金壁垒分析	
二、	智能座舱SoC芯片	行业技术壁垒分析	
三、	智能座舱SoC芯片	行业人才壁垒分析	
四、	智能座舱SoC芯片	行业品牌壁垒分析	
五、	智能座舱SoC芯片	行业其他壁垒分析	
第七节 中国	智能座舱SoC芯片	行业风险分析	
一、	智能座舱SoC芯片	行业宏观环境风险	
二、	智能座舱SoC芯片	行业技术风险	
三、	智能座舱SoC芯片	行业竞争风险	
四、	智能座舱SoC芯片	行业其他风险	
第四章 2020-2024年全球	智能座舱SoC芯片	行业发展现状分析	
第一节 全球	智能座舱SoC芯片	行业发展历程回顾	
第二节 全球	智能座舱SoC芯片	行业市场规模与区域分 布	情况
第三节 亚洲	智能座舱SoC芯片	行业地区市场分析	
一、	亚洲 智能座舱SoC芯片	行业市场现状分析	
二、	亚洲 智能座舱SoC芯片	行业市场规模与市场需求分析	

三、亚洲	智能座舱SoC芯片	行业市场前景分析	
第四节 北美	智能座舱SoC芯片	行业地区市场分析	
一、北美	智能座舱SoC芯片	行业市场现状分析	
二、北美	智能座舱SoC芯片	行业市场规模与市场需求分析	
三、北美	智能座舱SoC芯片	行业市场前景分析	
第五节 欧洲	智能座舱SoC芯片	行业地区市场分析	
一、欧洲	智能座舱SoC芯片	行业市场现状分析	
二、欧洲	智能座舱SoC芯片	行业市场规模与市场需求分析	
三、欧洲	智能座舱SoC芯片	行业市场前景分析	
第六节 2025-2032年全球	智能座舱SoC芯片	行业分布	走势预测
第七节 2025-2032年全球	智能座舱SoC芯片	行业市场规模预测	
【第三部分 国内现状与企业案例】			
第五章 中国	智能座舱SoC芯片	行业运行情况	
第一节 中国	智能座舱SoC芯片	行业发展状况情况介绍	
一、行业发展历程回顾			
二、行业创新情况分析			
三、行业发展特点分析			
第二节 中国	智能座舱SoC芯片	行业市场规模分析	
一、影响中国	智能座舱SoC芯片	行业市场规模的因素	
二、中国	智能座舱SoC芯片	行业市场规模	
三、中国	智能座舱SoC芯片	行业市场规模解析	
第三节 中国	智能座舱SoC芯片	行业供应情况分析	
一、中国	智能座舱SoC芯片	行业供应规模	
二、中国	智能座舱SoC芯片	行业供应特点	
第四节 中国	智能座舱SoC芯片	行业需求情况分析	
一、中国	智能座舱SoC芯片	行业需求规模	
二、中国	智能座舱SoC芯片	行业需求特点	
第五节 中国	智能座舱SoC芯片	行业供需平衡分析	
第六节 中国	智能座舱SoC芯片	行业存在的问题与解决策略分析	
第六章 中国	智能座舱SoC芯片	行业产业链及细分市场分析	
第一节 中国	智能座舱SoC芯片	行业产业链综述	
一、产业链模型原理介绍			
二、产业链运行机制			
三、	智能座舱SoC芯片	行业产业链图解	
第二节 中国	智能座舱SoC芯片	行业产业链环节分析	

一、上游产业发展现状	
二、上游产业对智能座舱SoC芯片	行业的影响分析
三、下游产业发展现状	
四、下游产业对智能座舱SoC芯片	行业的影响分析
第三节 中国智能座舱SoC芯片	行业细分市场分析
一、细分市场一	
二、细分市场二	
第七章 2020-2024年中国智能座舱SoC芯片	行业市场竞争分析
第一节 中国智能座舱SoC芯片	行业竞争现状分析
一、中国智能座舱SoC芯片	行业竞争格局分析
二、中国智能座舱SoC芯片	行业主要品牌分析
第二节 中国智能座舱SoC芯片	行业集中度分析
一、中国智能座舱SoC芯片	行业市场集中度影响因素分析
二、中国智能座舱SoC芯片	行业市场集中度分析
第三节 中国智能座舱SoC芯片	行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征	
二、企业规模分布特征	
三、企业所有制分布特征	
第八章 2020-2024年中国智能座舱SoC芯片	行业模型分析
第一节 中国智能座舱SoC芯片	行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理	
二、供应商议价能力	
三、购买者议价能力	
四、新进入者威胁	
五、替代品威胁	
六、同业竞争程度	
七、波特五力模型分析结论	
第二节 中国智能座舱SoC芯片	行业SWOT分析
一、SWOT模型概述	
二、行业优势分析	
三、行业劣势	
四、行业机会	
五、行业威胁	
六、中国智能座舱SoC芯片	行业SWOT分析结论
第三节 中国智能座舱SoC芯片	行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第九章 2020-2024年中国 智能座舱SoC芯片 行业需求特点与动态分析

第一节 中国 智能座舱SoC芯片 行业市场动态情况

第二节 中国 智能座舱SoC芯片 行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 智能座舱SoC芯片 行业成本结构分析

第四节 智能座舱SoC芯片 行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节 中国 智能座舱SoC芯片 行业价格现状分析

第六节 2025-2032年中国 智能座舱SoC芯片 行业价格影响因素与走势预测

第十章 中国 智能座舱SoC芯片 行业所属行业运行数据监测

第一节 中国 智能座舱SoC芯片 行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国 智能座舱SoC芯片 行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国 智能座舱SoC芯片 行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十一章 2020-2024年中国	智能座舱SoC芯片	行业区域市场现状分析
第一节 中国	智能座舱SoC芯片	行业区域市场规模分析
一、影响	智能座舱SoC芯片	行业区域市场分布的因素
二、中国	智能座舱SoC芯片	行业区域市场分布
第二节 中国华东地区	智能座舱SoC芯片	行业市场分析
一、华东地区概述		
二、华东地区经济环境分析		
三、华东地区	智能座舱SoC芯片	行业市场分析
（1）华东地区	智能座舱SoC芯片	行业市场规模
（2）华东地区	智能座舱SoC芯片	行业市场现状
（3）华东地区	智能座舱SoC芯片	行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析		
一、华中地区概述		
二、华中地区经济环境分析		
三、华中地区	智能座舱SoC芯片	行业市场分析
（1）华中地区	智能座舱SoC芯片	行业市场规模
（2）华中地区	智能座舱SoC芯片	行业市场现状
（3）华中地区	智能座舱SoC芯片	行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析		
一、华南地区概述		
二、华南地区经济环境分析		
三、华南地区	智能座舱SoC芯片	行业市场分析
（1）华南地区	智能座舱SoC芯片	行业市场规模
（2）华南地区	智能座舱SoC芯片	行业市场现状
（3）华南地区	智能座舱SoC芯片	行业市场规模预测
第五节 华北地区	智能座舱SoC芯片	行业市场分析
一、华北地区概述		
二、华北地区经济环境分析		
三、华北地区	智能座舱SoC芯片	行业市场分析
（1）华北地区	智能座舱SoC芯片	行业市场规模
（2）华北地区	智能座舱SoC芯片	行业市场现状
（3）华北地区	智能座舱SoC芯片	行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析		
一、东北地区概述		
二、东北地区经济环境分析		

三、东北地区	智能座舱SoC芯片	行业市场分析
（1）东北地区	智能座舱SoC芯片	行业市场规模
（2）东北地区	智能座舱SoC芯片	行业市场现状
（3）东北地区	智能座舱SoC芯片	行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析		
一、西南地区概述		
二、西南地区经济环境分析		
三、西南地区	智能座舱SoC芯片	行业市场分析
（1）西南地区	智能座舱SoC芯片	行业市场规模
（2）西南地区	智能座舱SoC芯片	行业市场现状
（3）西南地区	智能座舱SoC芯片	行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析		
一、西北地区概述		
二、西北地区经济环境分析		
三、西北地区	智能座舱SoC芯片	行业市场分析
（1）西北地区	智能座舱SoC芯片	行业市场规模
（2）西北地区	智能座舱SoC芯片	行业市场现状
（3）西北地区	智能座舱SoC芯片	行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国	智能座舱SoC芯片	行业市场规模区域分布
第十二章	智能座舱SoC芯片	行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一		
一、企业概况		
二、主营产品		
三、运营情况		
（1）主要经济指标情况		
（2）企业盈利能力分析		
（3）企业偿债能力分析		
（4）企业运营能力分析		
（5）企业成长能力分析		
四、公司优势分析		
第二节 企业二		
一、企业概况		
二、主营产品		
三、运营情况		
（1）主要经济指标情况		

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第三节 企业三

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

(1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第四节 企业四

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

(1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第五节 企业五

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

(1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第六节 企业六

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

(1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第七节 企业七

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

(1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第八节 企业八

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

(1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第九节 企业九

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第十节 企业十

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

(1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

【第四部分 展望、结论与建议】

第十三章 2025-2032年中国 智能座舱SoC芯片 行业发展前景分析与预测

第一节 中国 智能座舱SoC芯片 行业未来发展前景分析

一、中国 智能座舱SoC芯片 行业市场机会分析

二、中国 智能座舱SoC芯片 行业投资增速预测

第二节 中国 智能座舱SoC芯片 行业未来发展趋势预测

第三节 中国 智能座舱SoC芯片 行业规模发展预测

一、中国 智能座舱SoC芯片 行业市场规模预测

二、中国 智能座舱SoC芯片 行业市场规模增速预测

三、中国 智能座舱SoC芯片 行业产值规模预测

四、中国 智能座舱SoC芯片 行业产值增速预测

五、中国 智能座舱SoC芯片 行业供需情况预测

第四节 中国 智能座舱SoC芯片 行业盈利走势预测

第十四章 中国 智能座舱SoC芯片 行业研究结论及投资建议

第一节 观研天下中国 智能座舱SoC芯片 行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节 中国 智能座舱SoC芯片 行业进入策略分析

一、目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节	智能座舱SoC芯片	行业品牌营销策略分析
一、	智能座舱SoC芯片	行业产品策略
二、	智能座舱SoC芯片	行业定价策略
三、	智能座舱SoC芯片	行业渠道策略
四、	智能座舱SoC芯片	行业推广策略

第四节 观研天下分析师投资建议

详细请访问：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202508/760478.html>